

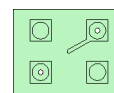
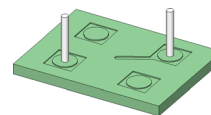


DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

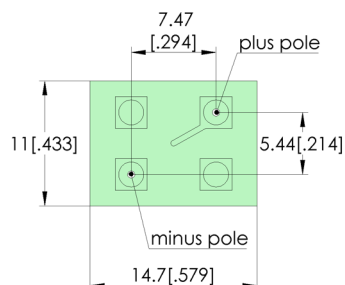
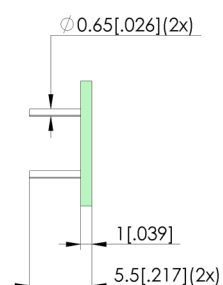
- Componenti per il test Opens per il test capacitivo di chip semiconduttori alla ricerca di guasti, cortocircuiti e difetti di saldatura
- Adatto ai sistemi di test Teradyne

Utilizzo

Le piastre sensore FrameScan Plus sono utilizzate per i test capacitivi dei circuiti integrati al fine di verificare le connessioni a filo all'interno di un circuito integrato per individuare circuiti aperti, cortocircuiti e difetti di saldatura.



1:1



Dati generali

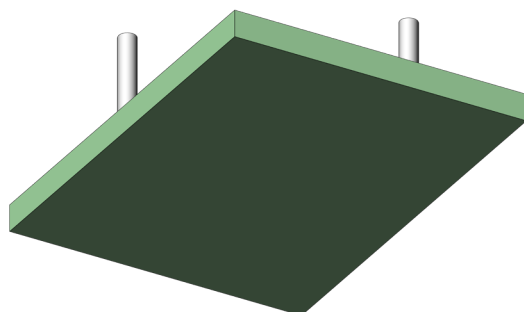
Gruppo di prodotti:	opens test
serie:	OTC
Tipo:	Teradyne opens test
Versione:	
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	Piastra sensore 015-011
Larghezza:	11 mm
Altezza:	5,5 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA): VA 20xx
 Kit di ricambio WS: WS Teradyne/TSH5x

Dati tecnici

Lunghezza: 14,7 mm
 Dimensioni esterne (LxPxA): 14,7 x 11 x 5,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

